2026年11月６日

各　　位

会 社 名：ウインテスト株式会社
（コード：6721 東証スタンダード市場）
代表者名：代表取締役　　姜　　輝
問合せ先：管理本部長 鎌田 文明
（ＴＥＬ：045-317-7888）

新事業「半導体の前工程検査装置事業」開始に関する日程変更のお知らせ

当社は、2025 年 12 月 26 日付「新事業「半導体の前工程検査装置事業」開始に関するお知らせ」にて公表いたしました「新たな事業に関する日程」ついて、下記のとおり、日程の一部を変更する決議を 2026 年 11 月６日開催の取締役会にて行いましたのでお知らせいたします。

記

１．変更の理由

当社は、2025 年 12 月 26 日付「第三者割当による第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」及び同日付「新事業「半導体の前工程検査装置事業」開始に関するお知らせ」並びに 2026 年６月 25 日付「資金使途支出予定時期の変更に関するお知らせ」にてお知らせのように、新規「前工程装置事業」立上げに関わる準備費用として２億 5600 万円（下記※１）を予定し、2027 年３月までに「半導体の前工程検査装置事業」立上げを計画しました。その資金計画のうち１億８千万円程度を新設クリーンルームの建設費用と想定いたしました。内訳詳細につきましては、12 月 26 日付「第三者割当による第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」の「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」」の「（２）調達する資金の具体的な使途」をご参照下さい。またその文中①において、クリーンルームに関する詳細を記載しております。

クリーンルームの工事期間については、当初予定通り、2026 年６月末までに無事、大阪事業所にて建設工事を完了しましたが、その費用は当初考えた予算１億８千万円の内である約１億 880 万円に収めることができました。理由として、工事期間中に発生した中東情勢等の地政学的影響による一部工事関連部材の調達遅延や、新株予約権による資金調達の進捗状況遅れなど懸念される状況が発生、そのため、工期終了予定時期に暗雲が漂いましたが、工事期間計画の見直しは行なわず、半導体前工程検査装置事業の立上げに影響が及ぶことを最小限に抑える施策を取りました。具体的には、建設クリーンルーム内、付帯設備内容の見直しや既存クリーンルーム設備の一部流用など、効率化を行い、新たな付帯設備導入をやめ、新設したクリーンルームの建設費用を低減しつつ工期を守ることができました。残りの資金は予定通り「半導体の前工程検査装置事業」開始の準備に向ける計画でした。その後、新株予約権の全ての行使が 2026 年 10 月 20 日に完了し、２割程度の調達予定金額の減額が判明し

たことから、「半導体の前工程検査装置事業」立上げに関わる準備費用や支出予定時期などの見直しを行ない、別途開示を行うことといたしました。

しかし、下記、４．で詳述いたしました当初予定していなかった新規引合いを頂くこととなりましたことから、調達資金の不足が発生する事態とはなりましたが、2027 年以降の事業展開および想定される事業規模を踏まえ、製造体制のさらなる拡充が必要と判断、かかる費用も 400 万円前後と軽微であるため、日程を変更追加し、新設したクリーンルームへの追加拡張建設工事を実施、工期終了を 2026 年 12 月末日とすることといたしました。

なお、本追加拡張工事については、第 13 回新株予約権による調達資金の一部を充当する方針とし、これに伴い、調達資金の使途および支出予定時期を見直し、変更することといたしました。

念のため、以下に当初の計画を抜粋し、記載いたします。

※１　当社は、2025 年 12 月 26 日公表「第三者割当による第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」にて

・新規「前工程装置事業」立上げに関わる準備費用として 256,000 千円(a)

(a)の内、クリーンルームの建設費用 並びに付帯設備を 200,000 千円(b)

(b)の内、さらに、クラス 1000 で 100 坪のクリーンルームの建設費用を 180,000 千円(c)

と見積もっております。

・尚、同日公表の「新事業「半導体の前工程検査装置事業」開始に関するお知らせ」の「４．新たな事業の開始のために特別に支出する金額及び内容」にて、「クリーンルームの建設費用並びに付帯設備 約 200 百万円」と記載しておりますが、それは(ｂ)と同じ内容です。

２．変更の内容

日程変更の内容は以下のとおりであります。（変更箇所は下線で示しております。）

(変更前)

1）取締役会決議日　　:2025 年 12 月 26 日

2）事業開始　　:2026 年 1 月 14 日

3）クリーンルーム完成　:2026 年 6 月　末

4）製造準備開始　　:2026 年 7 月～10 月（ノックダウン含む）

5）出荷開始と販売　　:2026 年 10 月～

(変更後)

1）取締役会決議日　　:2025 年 12 月 26 日　変更なし（決議済）

2）事業開始　　:2026 年 1 月 14 日　変更なし

3）クリーンルーム完成　:2026 年 6 月　末　変更なし

4）製造準備開始　　:2026 年 7 月～10 月（ノックダウン含む）変更なし

5）出荷開始と販売　　:2026 年 10 月～　変更なし

6）上記 3）に対する追加拡張工事完成　2026 年 12 月末

※ なお、上記４）及び５）の製造準備に関連し、当社は 2026 年７月末から８月にかけて、当社製の前工程検査装置を海外企業へ納入し、実際の半導体製造環境を想定した装置評価を進めております。その後、同年 10 月には当該装置の購入条件等について協議を行っておりますが、2026 年 12 月期中の売上計上は予定しておりません。今後、購入条件等の合意および必要な手続を経たうえで、2027 年 12 月期に売上計上することを目指しております。

３．本事業に関連する調達資金の使途、支出予定時期について

本事業に関連する調達資金の使途、支出予定時期の変更につきましては、2026 年 11 月６日付「第 13 回新株予約権による資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

４．新設クリーンルームへの追加拡張建設工事の必要性について

当社は、2025 年 12 月 26 日付「新事業『半導体の前工程検査装置事業』開始に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、半導体前工程検査装置事業への新規参入に向け、同日付「第三者割当による第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」に基づく調達資金の一部を活用し、大阪事業所における新設クリーンルームの建設および製造体制の構築を上述のように進めてまいりました。

一方、2026 年 10 月 15 日付で当社ウェブサイトに掲載いたしましたとおり、海外の大手半導体関連企業との間で、当社装置の導入に向けた協議を開始し、秘密保持契約（NDA）を締結いたしました。

また、同年 10 月 13 日付で開示いたしました「シリコンキャパシター向けウエハ検査装置 『WTS-513SC』の開発完了及び販売開始のお知らせ」のように、新領域であるシリコンキャパシター向けウエハ検査装置事業についても、今後の事業展開に伴い、クリーンルーム設備を使用する機会の増加が見込まれます。こうした新規案件への対応および複数事業における設備利用の可能性を総合的に勘案した結果、新たに建設したクリーンルームの機能を維持しつつ、今後の製造・評価能力の増強を図る必要があると判断し、このたびの取締役会において、2026 年 12 月末までに新設されたクリーンルームと既存クリーンルームの一体化を可能とする上述、追加拡張工事を実施することを決議いたしました。

４．事業展開について

当社は、2026 年 12 月末までにクリーンルーム追加拡張工事の完成を目指すとともに、既存設備の有効活用や製造工程の最適化を通じて、効率的かつ安定した製造体制の構築を進めてまいります。

また、製造エンジニアの育成、顧客による実機評価および国内外の顧客開拓を継続し、2027 年３月からの本格的な事業展開を目指してまいります。当社は、今回のクリーンルームの追加拡張を、製造・品質管理体制の確立と今後の事業拡大に向けた準備を着実に進めるための見直しと位置付けております。

今後は、国内市場に加え、台湾、シンガポール、インド等の海外市場における顧客開拓を推進し、半導体前工程検査装置事業を当社の新たな収益基盤の一つとして育成してまいります。なお、大手海外顧客との装置導入を前提としたNDA（秘密保持契約）の締結や現状の詳細につきましては、当社ホームページに詳しいご案内を掲載しておりますので合わせてご覧ください。

５．今後の見通しと影響

本変更が、当社グループの2026年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
今後開示すべき変更などが発生した場合は別途お知らせいたします。

以上